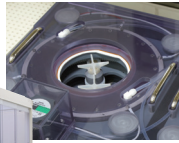
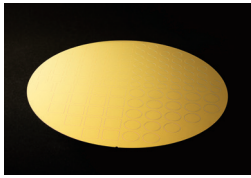


めっきプロセスのトータルソリューション

High performance plating materials and equipment

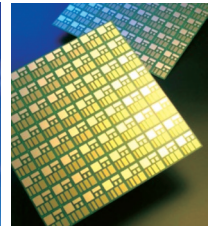
● ウェハー用めっき装置

ビアフィリング、鉛フリー、ピラーバンプ
めっきプロセスに適用可能なめっき装置



● 電子部品用金めっき

TEMPEREX Series
高品質の析出膜が得られる
電解純金めっき液



Au

Equipment

Other

● 剥離剤

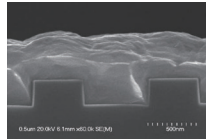
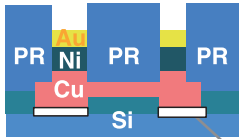
HAKUREX Series
各種めっきの剥離に対応

● カビ防止剤

EETOREX 300
めっき液や回収槽で発生するカビを抑制

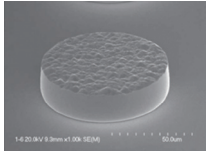
● 銅-ニッケルめっき

**MICROFAB Cu Series,
MICROFAB Ni Series**
ウェハー上のバンプ、配線、フィルドビア、
トレンチめっき等に適用可能

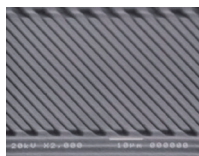
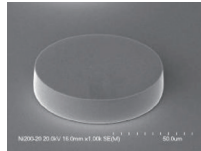


85μmφ-35μmDepth Pad

● MICROFAB Cu200



● MICROFAB Ni200



Cu

Ni

In

Sn

Ru

Ir

Pt

Rh

Neutrality
Pd

Strike
Au

Au alloy

Non-
cyanide
Au

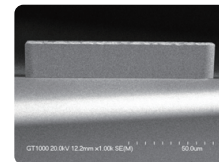
Non-
cyanide
Ag

● SUS上ダイレクト 金ストライクめっき

AUROBOND Series
SUS上に直接金めっきが可能な
塩素フリーの金ストライクめっき液

● 金/スズ合金めっき

GALVANOMEISTER GT Series
接合材料として使用可能



● ノンシアン無電解金めっき

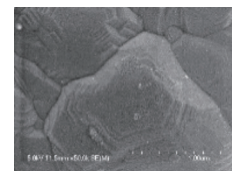
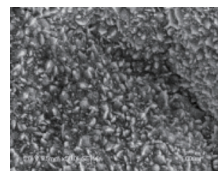
LECTROLESS Series
低金濃度で下地腐食を抑え、
薄付けが可能

● ノンシアン電解銀めっき

PRECIOUSFAB Ag Series
パターン形成、厚付けが可能

● 無電解白金めっき

LECTROLESS Pt Series
セラミック・プラスチック等の絶縁材料などに
地金使用効率の高い無電解白金めっき液



● 中性パラジウムめっき

PALLADEX ADP/ADG Series
レジストコートされた基板にも
適用可能



田中貴金属グループ
<https://tanaka-preciousmetals.com>

